证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-051

泰晶科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次向特定对象发行股票于 2027 年 6 月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、本次发行前公司总股本为 385,887,492 股，按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，即为 115,766,247 股（含本数），本次发行完成后公司总股本为 501,653,739 股，前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成数量为准；

4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本 385,887,492 股为基础。除此之外，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；

5、2026 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东净利润为 10,591.45 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 8,628.75 万元。假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为公司 2026 年 1-9 月已实现的相应指标乘以 4/3；对于公司 2027 年度净利润，假设在 2026 年度的基础上按照持平、增长 10%、下降 10%进行测算。此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2027 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算如下：

项目	2026年度/2026年12月31日（预测）	2027年度/2027年12月31日（预测）	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	38,588.75	38,588.75	50,165.37
本次发行数量（万股）			11,576.62
假设情形一：2027年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2026年持平			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	14,121.94	14,121.94	14,121.94

归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	11,504.99	11,504.99	11,504.99
基本每股收益（元/股）	0.37	0.37	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.37	0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.26
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.26
假设情形二：2027年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2026年增长10%			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	14,121.94	15,534.13	15,534.13
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	11,504.99	12,655.49	12,655.49
基本每股收益（元/股）	0.37	0.40	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.40	0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.29
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.29
假设情形三：2027年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2026年下降10%			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	14,121.94	12,709.74	12,709.74
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	11,504.99	10,354.50	10,354.50
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.33	0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.30	0.27	0.23
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.30	0.27	0.23

注：1、对每股收益的计算，公司按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中的规定进行计算；2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴

于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，本次向特定对象发行股票完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行对即期回报的摊薄影响发生变化的可能性。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见《泰晶科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

公司是国内石英晶体频率元器件领域的领军企业，产品覆盖无源谐振器与有源振荡器全系列，频率范围从低频 kHz 至 625MHz。公司掌握光刻 TF、AT 切晶片加工，石英 MEMS 微纳加工，晶圆级封装与振荡器 IC 倒装，以及宽温高精度温度补偿等核心工艺。

高频低抖动体声波（BAW）振荡器研发与产业化项目与现有石英晶体振荡器同属频率控制与选择元件，在信号链中承担同一职能。项目产品覆盖 156.25MHz、312.5MHz、625MHz、1250MHz，与现有超高频差分晶振频点直接衔接，可沿用既有的差分链路设计、晶圆级封装、频率标定与客户认证体系。

研发中心建设项目依托公司现有技术积累，拟建设 MHz 级硅 MEMS 谐振器、32.768 kHz 硅 MEMS 振荡器和高精度温度补偿型晶振三类研发平台，提升器件

设计、样品试制、工艺验证和可靠性评价能力。研发中心形成的封装测试和可靠性评价能力，可为高频低抖动体声波（BAW）振荡器研发与产业化项目提供共性技术支持。

高精度石英频率元器件扩产项目分随州与越南两地，项目建成后新增系列产品属现有产品的产能与产地延伸。

智能制造与数字化底座升级项目依托公司已建成的信息系统架构与工序自动化经验迭代升级，目的是稳定良率、提高制程稳定性、提升柔性换产与交付能力，改造后客户渠道、市场资质与质量认证体系均可延续复用。

本次募集资金投向均围绕现有频率元器件主业展开，各项目分别承担高端品类突破、底层技术平台建设、现有产能扩张与制造体系升级职能，相互衔接、均不涉及跨界投资，项目实施后公司主营业务不发生变化。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司近年引进 MEMS、半导体、高频器件领域高端人才与学科带头人，在 MEMS、体声波（BAW）振荡器等领域形成专业梯队。目前核心技术人员建制覆盖系统方案设计、MEMS 器件仿真、版图开发、晶圆级封装开发、可靠性验证与技术支持，核心技术骨干主要毕业于国内知名院校，具备物理、微电子、化学、自动化、机械等多领域多学科专业背景。

2、技术储备

公司自 2011 年布局石英 MEMS 技术，2014 年组建国内同行业首家微纳米晶体加工技术重点实验室，掌握光刻、晶片刻蚀、等离子平坦化等工艺，是全球少数能同步满足 AI 算力芯片对智能硬件高性能、低功耗要求的晶体厂商。公司通过引入并掌握半导体制程的光刻工艺，能够在晶片中心区域蚀刻出超薄的共振部分，同时保留外围结构以维持强度，从而稳定量产 100MHz 至 625MHz 范围的高基频晶振；创新升级半导体晶圆级封装技术，实现超薄、超小器件的封装厚度由 400 至 500 微米减薄至 130 微米；突破振荡器 IC 倒装并应用于全系列有源产品，自研温补算法实现±0.05ppm 超高稳定度方案，并建成全自动温补校准平台

与智能校准软件。体声波（BAW）振荡器方向，公司已具备工艺架构设计、晶圆级封装与系统级封装设计能力。

3、市场储备

公司聚焦物联网、移动终端、工业控制、电力能源等关键领域，终端大客户渗透率持续提升，TKD 成为一批优质客户主力供应商品牌；以“石英晶振+硅振”布局全频段产品，现有超高频差分晶振已覆盖当前主流及后续演进速率等级所需的频点，与体声波（BAW）振荡器频点一致，客户验证与认证记录可直接沿用，并已成功进入全球头部芯片厂商、通信设备商、AI 算力企业供应链，同时储备石英+硅 MEMS+BAW 方案，将进一步满足高速互联相关需求。在汽车电子方面，Global TOP100 在内的国内外头部客户持续导入中，部分车规项目获多家主机厂唯一国产供应商资格，1612 封装、19.2MHz 石英谐振器已通过高通骁龙 AR1+ Gen 1 智能眼镜平台认证；公司采用直销为主、分销为辅的销售模式，在海外设营销驻点，越南基地建成后可就近承接海外订单，在与各行业终端客户的深度互动中，公司凭借全域化、定制化、差异化产品，可充分满足全球客户的多样化需求。

综上所述，公司本次发行募投项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备，能够保证项目的顺利实施。

五、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的具体填补措施

为有效防范本次向特定对象发行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，保证此次募集资金的有效使用，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：

（一）加快公司主营业务的发展，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将持续加强技术研发和工艺升级，加快新产品研发及产业化，优化产品结构，提升高附加值产品占比；同时，深化现有客户合作，积极拓展汽车电子、工业控制、物联网、通信设备及智能终端等领域市场，并通过精益生产、质量管理、供应链优化和成本费用管控提高经营效率，进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力，努力降低本次发行对即期回报摊薄的影响。

（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率

为规范募集资金使用管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、审批、监督管理等作出了明确规定。

本次募集资金到位后，公司将严格遵守《募集资金管理制度》，开设募集资金专项账户，按照约定用途合理使用募集资金，并积极配合保荐机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督，确保公司规范、有效使用募集资金。

（三）完善公司治理结构，强化内部控制管理

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求，不断完善公司法人治理结构，确保股东以及董事会、独立董事、董事会审计委员会能够充分有效行使相应权利和职责，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，优化预算管理流程，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

（四）严格执行利润分配政策，优化投资回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，制订了公司《未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）》。本次向特定对象发行股票完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。

公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬请广大投资者注意投资风险。

六、相关主体出具的承诺

（一）公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会的相关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票摊

薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行，作出以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺如公司后续推出股权激励政策，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管部门制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司控股股东、共同实际控制人的承诺

为保证本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、共同实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、承诺将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并由此给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者相应的补偿责任。

3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按

照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日